



导热胶

性能

- 无需使用螺丝或机械件，减少设备尺寸和重量
- 适用于将PCB板的发热部件与金属外壳或散热器粘接
- 保持极薄的胶层及极佳的导热路径
- 可提供常温、加温或催化剂固化三种解决方案

主要应用

- 汽车电子
- 计算机和外围设备
- 远程通信



粘接

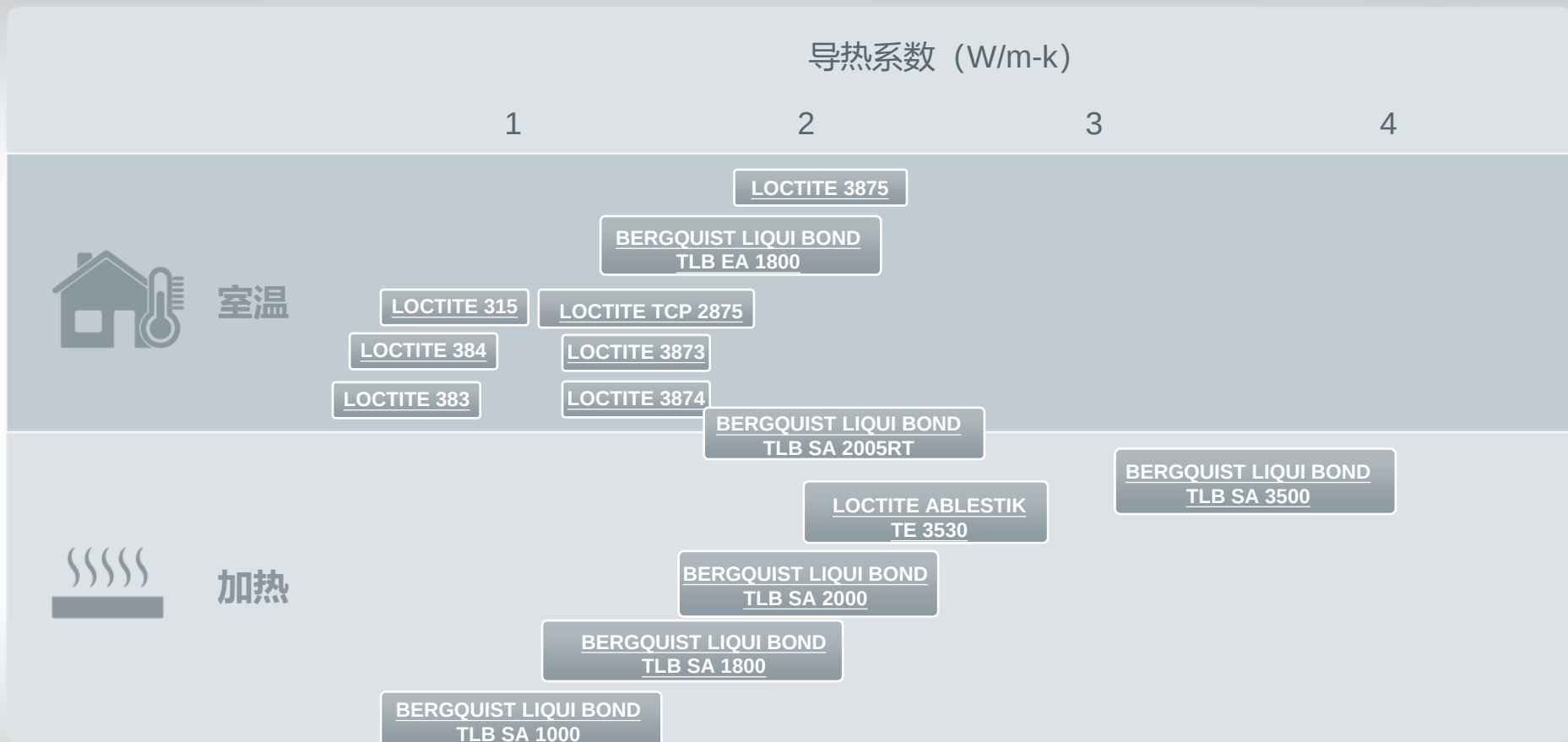


液态





导热胶



产品	描述	导热系数 (W/m-k)	粘度 (cP)	固化方式
LOCTITE 315	单组份, 自填隙、膏状导热胶, 用于散热器与电子部件之间的绝缘粘接	0.81	600,000	室温固化
LOCTITE 383	高强度、室温固化导热胶, 用于组件永久性粘接	0.6	500,000	室温固化
LOCTITE 384	可拆卸, 室温固化导热胶, 用于需拆卸的零件	0.76	100,000	室温固化
LOCTITE TCP 2875	导热粘合剂, 用于将电气元件与绝缘间隙的散热片粘接	1.2	38,000	室温固化
LOCTITE ABLESTIK TE 3530	单组份, 低温固化, 导热环氧粘合剂	2.3	60,000	30 分钟 @ 100°C
LOCTITE 3873	单组份、自填隙 (与活化剂7387一起使用) 高粘结强度, 适用于散热片应用	1.25	200,000	室温固化
LOCTITE 3874	快速固化、高导热的导热胶, 用于发热器件与散热器的粘接	1.25	800,000	室温固化
LOCTITE 3875	双组份, 液态丙烯酸导热胶	1.75	A组份: 6,500 B组份: 2.5rpm时, 19,000 A组份: 3,200 B组份: 20rpm时, 9000	室温固化



粘接



液态



产品	描述	导热系数 (W/m-k)	粘度 (cP)	使用温度 (°C)	固化方式	阻燃等级 (UL 94)
BERGQUIST LIQUI BOND TLB SA 2005RT	双组分、高性能、硅基导热胶，专为汽车等需要高可靠性应用而设计	2.0	70,000	-60 - 180	6 小时 @ 25°C 30 分钟 @ 50°C 5 分钟 @ 85°C	V-0
BERGQUIST LIQUI BOND TLB SA 3500	双组份，高温固化，液态硅基导热胶，在恶劣环境中保持结构的粘接	3.5	A组份： 4,500 B组份： 3,000	-60 - 200	20 分钟 @ 125°C 10 分钟 @ 150°C	V-0
BERGQUIST LIQUI BOND TLB SA 2000	单组份，硅基导热胶	2.0	200,000	-60 - 200	20 分钟 @ 125°C 10 分钟 @ 150°C	V-0
BERGQUIST LIQUI BOND TLB EA 1800	双组份，环氧基，室温固化，可点胶操作导热胶	1.8	A组份： 6,000 B组份： 6,200	-40 - 125	室温固化	V-0
BERGQUIST LIQUI BOND TLB SA 1800	单组份，液态硅基导热胶	1.8	125,000	-40 - 125	20 分钟 @ 125°C 10 分钟 @ 150°C	V-0
BERGQUIST LIQUI BOND TLB SA 1000	单组份，硅基导热胶	1.0	125,000	-60 - 200	20 分钟 @ 125°C 10 分钟 @ 150°C	V-0